



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

*2015年12月8日に発表されたプレスリリースの抄訳です

JA 三井リース株式会社、パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社へ の2020年満期の85億円(約7000万ドル)の追加融資契約を締結

東京、京都(日本)およびミグダル・ハエメク(イスラエル) – 2015年12月8日 – グローバルスペシャルティファウンドリーリーダーのタワージャズは本日、パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社(TPSCo)への85億円(約7000万ドル)の追加的長期貸し付けのために、JA 三井リース、三井住友信託銀行、昭和リースという日本の大手金融機関との5年間の融資契約に正式署名したことを発表しました。この融資の年利はTIBORレートプラス2%、満期は2020年度第4四半期で、返済は契約締結の二年後から始まり、半年毎の7分割均等払いです。この新規融資は、2016年に返済が開始し同年中に25億円が返済される予定の88億円の既存融資に追加されるものです。

JA 三井リースのグローバル営業本部長である土井 清視氏は次のように述べています。「私どもは、パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社の創立以来の大きな前進と成長、そして将来の見込みを目にすることを大変喜んでおります。約2年前に私どもに提出された当初の事業計画は、どれも順調に進んでいます。この契約締結により、パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社との取引をさらに拡大できることを嬉しく思っております。」

また、パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社のCFOであるAmit Mappa氏は次のように述べています。「今回のJA 三井リース、三井住友信託銀行、昭和リースとの融資契約の締結を非常に喜んでおります。この契約は、現在当社で継続中の事業および経営の成長戦略を実現させるための有力な鍵であり、また、財務成績を強化しつつ生産能力と顧客基盤をさらに拡大するという当社の計画にも沿うものであると

信じています。」

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE: TSEM)は、米国にある完全子会社ジャズセミコンダクター社とともに、タワージャズというブランド名でグローバルに事業展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは、集積回路を生産し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネジメント (BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセス技術を幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントプラットフォームを提供し、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services(TOPS)を提供しています。詳細は www.towerjazz.com をご覧ください。

複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 1 か所(200mm)のファブに加え、タワージャズが過半数の株式を保有するパナソニック社と設立したパナソニック・タワージャズ セミコンダクター社(TPSCo)の日本の 3 拠点(200mm と 300mm)のファブと連携しています。TPSCo を通じて、タワージャズは、最先端のイメージセンサ技術を含む、先端の 45nm CMOS、65nm RF CMOS および 65nm 1.12um ピクセル技術の提供が可能となります。詳細は www.tpsemico.com をご覧ください。

パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社について

パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社(TPSCo)は、パナソニック社 (NASDAQ ADS: PCRFY, TYO: 6752) によって設立され、タワーセミコンダクター社(NASDAQ: TSEM, TASE: TSEM)が 51%、パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社が 49%の株式を保有する合弁会社です。TPSCo は、30 年以上の製造実績がある北陸地区の 3 工場で大規模集積回路を製造しています。主なプロセス技術は、高感度イメージセンサ (CIS および CCD)、パワーデバイス(BCD、SOI、LDMOS)、高周波 RFCMOS などです。200mm および 300mm のウェハでサブミクロンから 45nm まで 120 を超えるプロセスフローと内製のバックエンドプロセス、アッセンブリ・テストサービスにより、TPSCo は、IDM とファブレス企業の双方にインハウスタンキーサービスを含め、これまでより優れた半導体製造の品質と技術を提供しています。詳細は www.tpsemico.com をご覧ください。

CONTACTS:

Noit Levy-Karoubi | VP Investor Relations | TowerJazz | +972 4 604 7066 | Noit.levi@towerjazz.com

GK Investor Relations | Kenny Green | (646) 201 9246 | towerjazz@gkir.com